

机构预期二季度晶圆代工报价有望走高

——中山证券电子行业周报

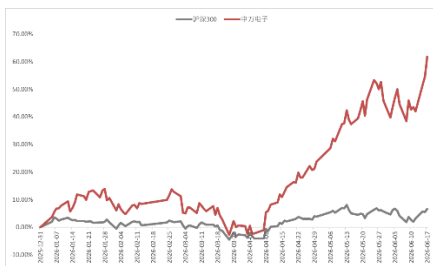
中山证券研究所

分析师：葛淼

登记编号：S0290521120001

邮箱：gemiao@zszy.com

市场走势



投资要点：

●**英伟达计划融资 200 亿美元。**据路透社报道，英伟达计划通过在美国发行债券筹集 200 亿美元。英伟达上一次进入投资级债券市场是在 2021 年 6 月，当时融资规模为 50 亿美元。报道称英伟达拟发行七档债券，最晚将于 2056 年到期。募资所得将用于一般公司用途，包括偿还及再融资现有票据。摩根大通、摩根士丹利和高盛担任此次发行的联席承销商。

●**机构预期二季度晶圆代工报价有望走高。**TrendForce（集邦）根据其最新晶圆代工产业研究表示，晶圆代工服务市场 2026 年第 1 季度整体呈现“淡季不淡”。对于 2026Q2，机构认为电视与 PC 产业的提前备货红利仍将延续，叠加智能手机需求回升，晶圆代工产能利用率也将走高，带动报价上涨。另一方面，AI 相关先进制程与功率产品需求成长动能优于预期，也带动产业订单外溢与产能排挤效应。总的来看，晶圆代工十巨头的营收在本季度将加速增长，再创新高。

◎**回顾本周行情（6月11日-6月17日）**，本周上证综指上涨 2.88%，沪深 300 指数上涨 3.85%。电子行业表现强于大盘。电子(申万)上涨 13.44%，跑赢上证综指 10.56 个百分点，跑赢沪深 300 指数 9.59 个百分点。电子在申万一级行业排名第二。行业估值方面，本周 PE 估值上升至 91.98 倍左右。

◎**行业数据：**一季度全球手机出货 2.89 亿台，同比增长-4.07%。中国 4 月智能手机出货量 2503 万台，同比增长 12.3%。4 月，全球半导体销售额 1104.8 亿美元，同比增长 93.89%。4 月，日本半导体设备出货量同比增长 14.12%。

◎**行业动态：**英伟达计划融资 200 亿美元；机构下调 2026 年面板出货量预期；证监会同意长鑫科技科创板上市申请；机构预期二季度晶圆代工行业报价有望走高。

◎**公司动态：**深南电路：拟定增募资 48.82 亿元。

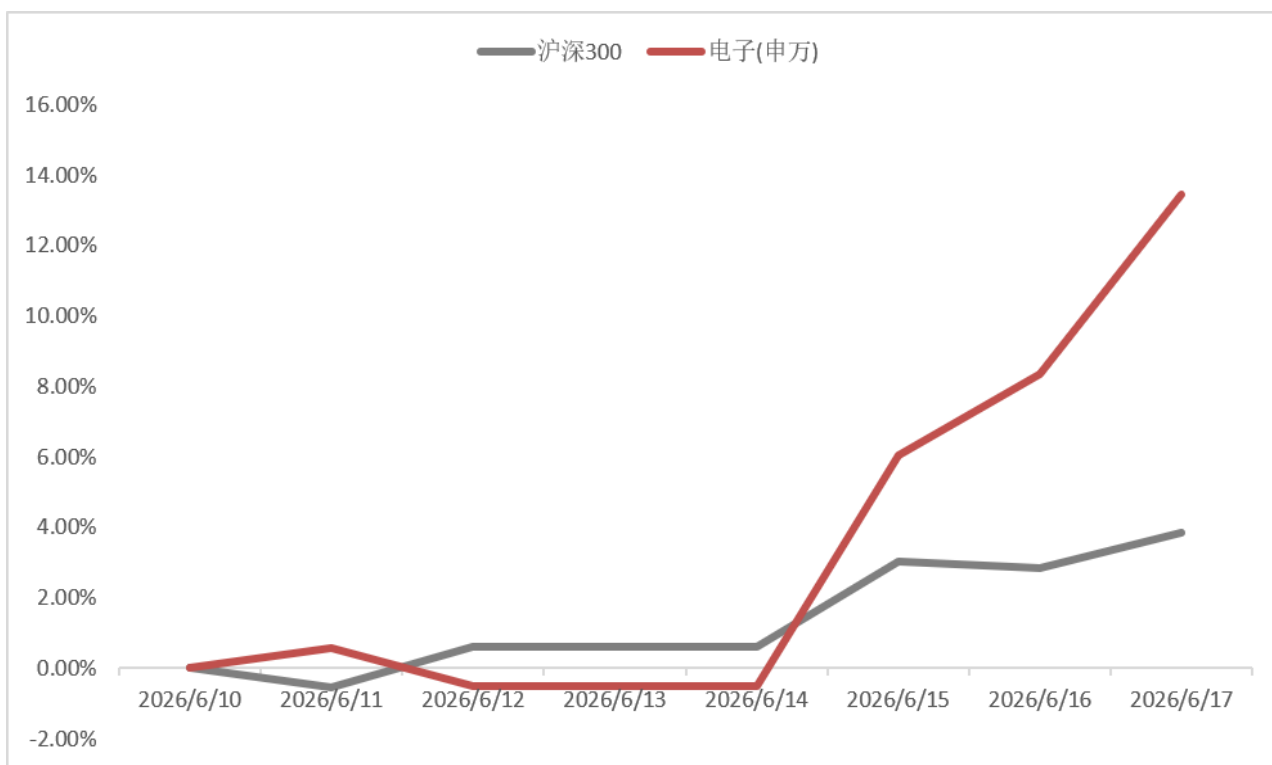
◎**投资建议：**下游手机销售量增速放缓，未来手机产业链上的消费电子和半导体器件公司业绩超预期的可能性降低。受 AI 相关需求拉动，存储芯片和生产存储芯片相关的设备和材料需求较好，服务器相关零部件需求较好。

风险提示：宏观需求转弱，上游原材料成本超预期，行业竞争格局恶化，贸易冲突影响。

1. 指数回顾

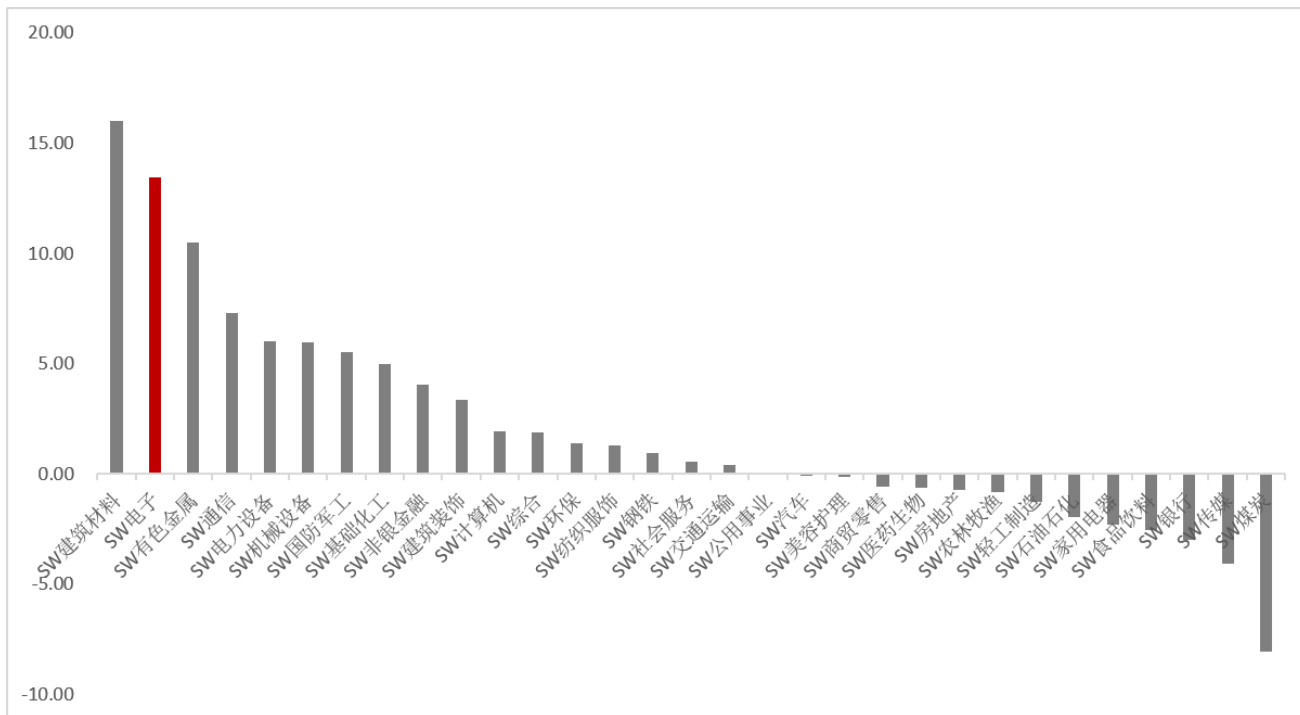
回顾本周行情（6月11日-6月17日），本周上证综指上涨2.88%，沪深300指数上涨3.85%。电子行业表现强于大盘。电子(申万)上涨13.44%，跑赢上证综指10.56个百分点，跑赢沪深300指数9.59个百分点。重点细分行业中，半导体(申万)上涨13.69%，跑赢上证综指10.82个百分点，跑赢沪深300指数9.84个百分点；其他电子II(申万)上涨16.77%，跑赢上证综指13.9个百分点，跑赢沪深300指数12.92个百分点；元件(申万)上涨17.58%，跑赢上证综指14.7个百分点，跑赢沪深300指数13.73个百分点；光学光电子(申万)上涨10.41%，跑赢上证综指7.54个百分点，跑赢沪深300指数6.56个百分点；消费电子(申万)上涨7.62%，跑赢上证综指4.74个百分点，跑赢沪深300指数3.77个百分点。电子在申万一级行业排名第二。行业估值方面，本周PE估值上升至91.98倍左右。

图1. 电子行业本周走势



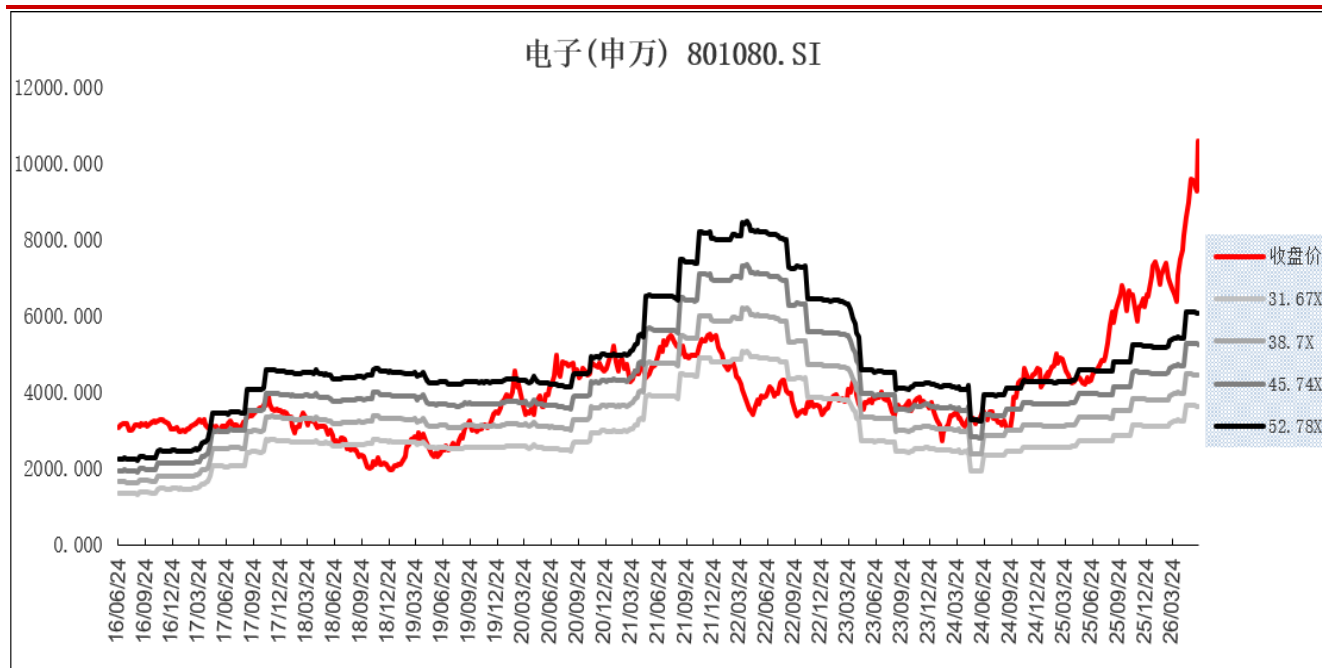
资料来源：Wind，中山证券研究所

图2. 申万一级行业本周排名



资料来源: Wind, 中山证券研究所

图3. 电子行业 PE 区间



资料来源: Wind, 中山证券研究所

2.本周观点

全球手机销量同比增速下降。根据 IDC 数据, 2026 年第一季度智能手机出货 2.89 亿台, 同比增长-4.07%, 相比 2025 年四季度的 2.28% 小幅下降。

国内手机销量同比增速回升。根据信通院数据，中国 2026 年 4 月智能手机出货量 2503 万台，同比增长 12.3%。增速相比 2026 年 3 月的-6.3%有所回升。

本轮手机销量下滑始于 2024 年四季度，按照下行一年到一年半的一般性规律，预计 2026 年上半年手机销量依然较为平淡，手机产业链公司业绩超预期的可能性较低。

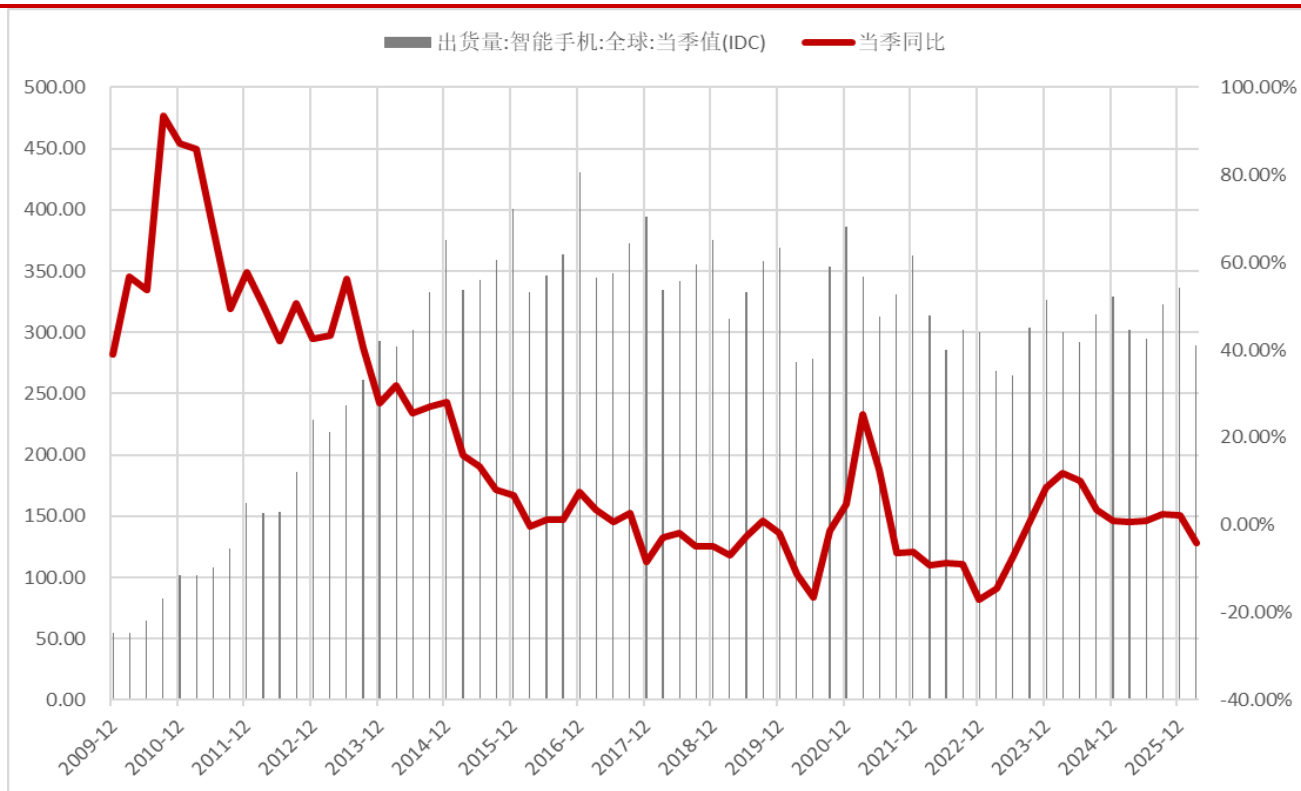
半导体行业景气度上升。2026 年 4 月，全球半导体销售额 1104.8 亿美元，同比增长 93.89%，相比 2026 年 3 月 79.20%的增速有所上升。

半导体设备景气度上升。2026 年 4 月，日本半导体设备出货量同比增长 14.12%，相比 2026 年 3 月增速 11.05%有所上升。

半导体行业景气需求分化，以消费电子为代表的国内半导体需求增速放缓，但与 AI 相关的存储芯片、光芯片相关细分赛道较为景气。能从国内存储厂扩产中获得新订单的半导体设备材料公司有望获得好于行业的表现。

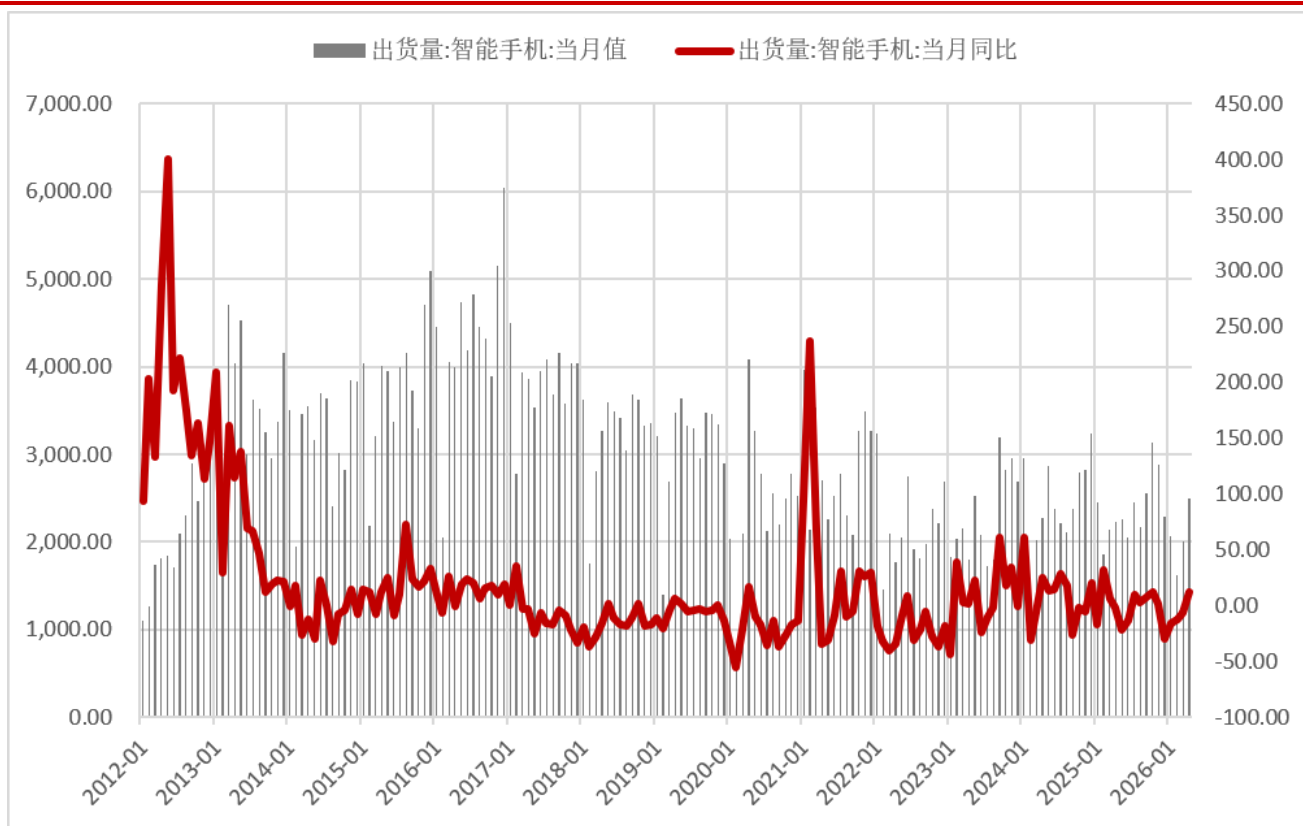
综上所述，下游手机销售量增速放缓，未来手机产业链上的消费电子和半导体器件公司业绩超预期的可能性降低。受 AI 相关需求拉动，存储芯片和生产存储芯片相关的设备和材料需求较好，服务器相关零部件需求较好。

图4. 全球智能手机出货量（单位：百万台）



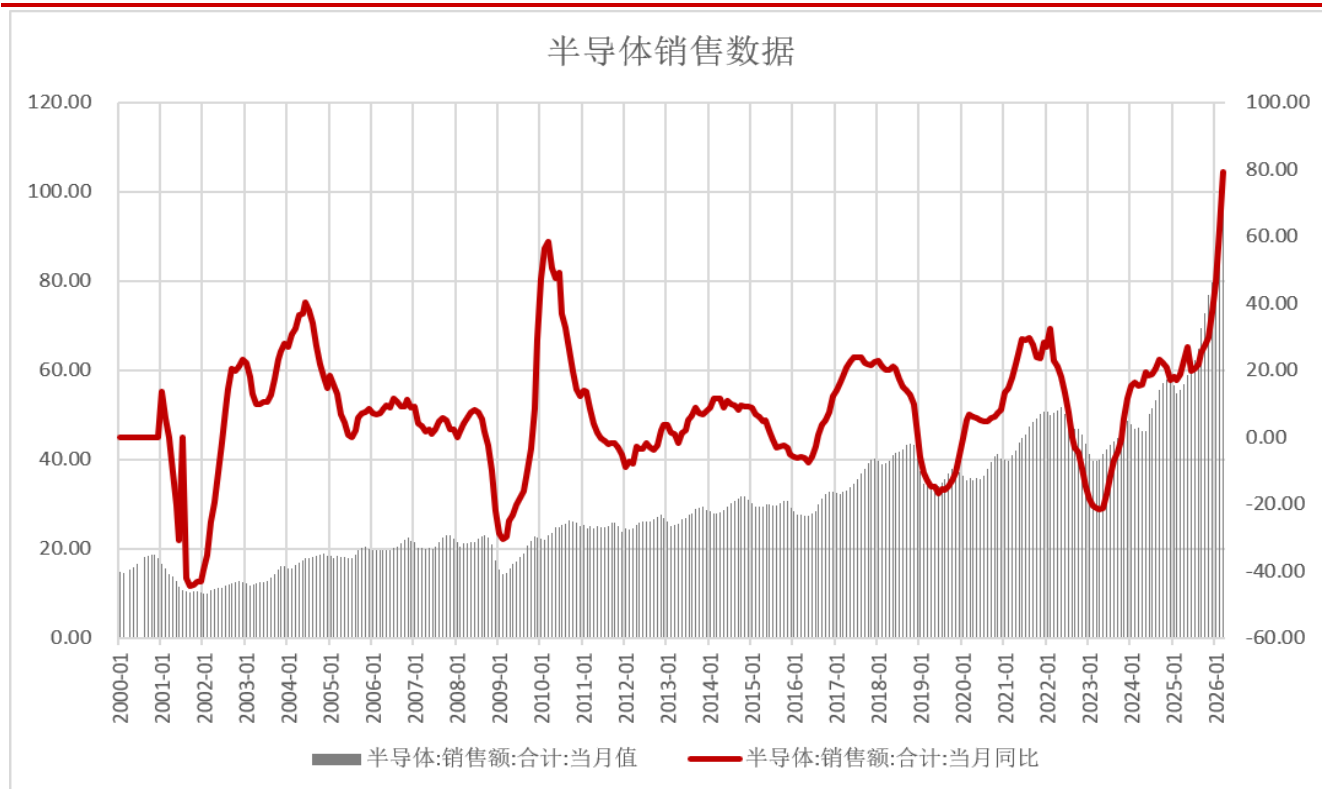
资料来源：IDC，中山证券研究所

图5. 国内智能手机出货量 (单位: 万台)



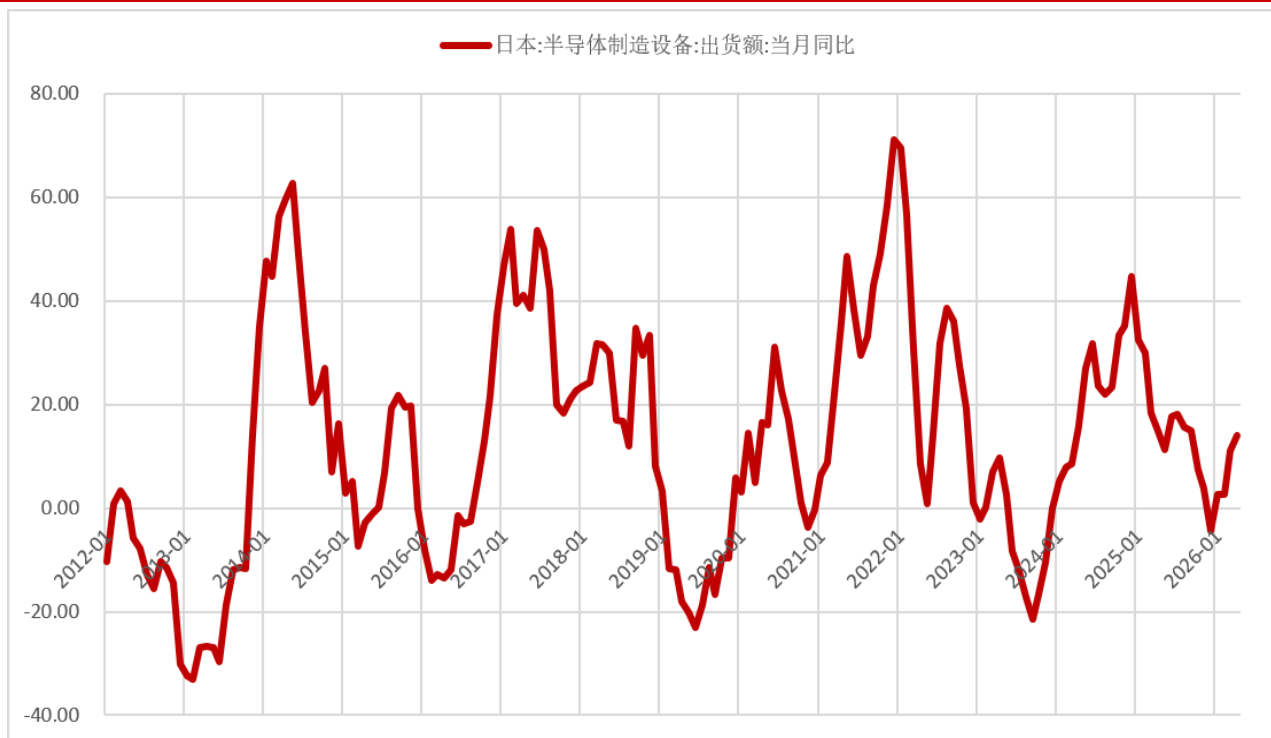
资料来源: 信通院, 中山证券研究所

图6. 全球半导体销售额 (单位: 十亿美元)



资料来源: 美国半导体产业协会, 中山证券研究所

图7. 日本半导体设备制造商出货量同比



资料来源: wind, 中山证券研究所

3.行业动态点评

3.1.英伟达计划融资 200 亿美元

据路透社报道，英伟达计划通过在美国发行债券筹集 200 亿美元。

英伟达上一次进入投资级债券市场是在 2021 年 6 月，当时融资规模为 50 亿美元。

报道称英伟达拟发行七档债券，最晚将于 2056 年到期。募资所得将用于一般公司用途，包括偿还及再融资现有票据。摩根大通、摩根士丹利和高盛担任此次发行的联席承销商。

尽管英伟达并未直接参与建设大规模的数据中心，但随着各大企业竞相训练并运行日益先进的模型，对驱动这些服务器的英伟达芯片的需求正持续火爆。为了与快速发展的 AI 行业保持同步，英伟达需要投入巨资研发最先进的处理器。

(信息来源: IT 之家)

3.2.机构下调 2026 年面板出货量预期

机构 Omdia 在下调了对 2026 年显示面板市场的展望，认为在需求大幅萎缩的背景下该市场面临更多负面因素，对按数量计出货的预期从此前的-2%调整至-6%、按面积计出货也从+6%降至+1%。

Omdia 认为 2026 年电视面板需求预计将同比下降 2.0%；该机构还将对全年笔记本电脑显示面板的需求预测下降约 720 万台。

上游组件价格飙升正迫使终端设备制造商必须在具有竞争力的定价与不断上涨的生产成本之间寻求平衡，这可能导致规格下调或利润率缩减。而如果新定价过高，那么消费者的购买意愿将遭遇持续遏制。

（信息来源：IT 之家）

3.3.证监会同意长鑫科技科创板上市申请

中国证监会公示，证监会同意长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。

根据招股书，长鑫科技此次 IPO 拟募资 295 亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM 存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目等项目。

2026 年 1-3 月，长鑫科技营业收入 508 亿元，同比增长 719.13%；净利润 330.11 亿元；归属于母公司所有者的净利润 247.62 亿元；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润 263.41 亿元。

长鑫科技预计 2026 年上半年实现营业收入 1100 亿元至 1200 亿元，同比增长 612.53%至 677.31%；实现归母净利润 500 亿元至 570 亿元，同比增长 2244.03%至 2544.19%。

（信息来源：IT 之家）

3.4.机构预期二季度晶圆代工报价有望走高

TrendForce（集邦）根据其最新晶圆代工产业研究表示，晶圆代工服务市场 2026 年第一季度整体呈现“淡季不淡”，十大市场参与者合计营收达 479.53 亿美元，环比+3.7%、同比+31.7%。

机构表示，尽管 Q1 是传统意义上的智能手机供应链淡季，但今年一方面 AIHPC 与相关周边订单出货旺盛，同时电视、PC 供应链也提前拉货，带动产业增长。

对于 2026Q2，机构认为电视与 PC 产业的提前备货红利仍将延续，叠加智能手机需求回升，晶圆代工产能利用率也将走高，带动报价上涨。另一方面，AI 相关先进制程与功率产品需求成长动能优于预期，也带动产业订单外溢与产能排挤效应。总的来看，晶圆代工十巨头的营收在本季度将加速增长，再创新高。

(信息来源：IT 之家)

4. 公司动态

4.1. 深南电路：拟定增募资 48.82 亿元

深南电路（002916.SZ）发布公告称，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 48.82 亿元。该笔募资扣除发行费用后，36 亿元将用于无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目，剩余 12.82 亿元用于补充流动资金。据介绍，前述募投项目主要生产高速高密多层 PCB 产品，应用于 AI 服务器、交换机等领域，建设期为 1 年。

(信息来源：央广财经)

风险提示：宏观需求转弱，上游原材料成本超预期，行业竞争格局恶化，贸易冲突影响。

分析师介绍:

葛森: 中山证券研究所行业组 TMT 行业分析师。

投资评级的说明

— 行业评级标准

报告列明的日期后3个月内，以行业股票指数相对同期市场基准指数（中证800指数）收益率的预期表现为标准，区分为以下四级：

强于大市： 行业指数收益率相对市场基准指数收益率在5%以上；

同步大市： 行业指数收益率相对市场基准指数收益率在-5%~5%之间波动；

弱于大市： 行业指数收益率相对市场基准指数收益率在-5%以下；

未评级： 不作为行业报告评级单独使用，但在公司评级报告中，作为随附行业评级的选择项之一。

— 公司评级标准

报告列明的发布日期后3个月内，以股票相对同期行业指数收益率为基准，区分为以下五级：

买入： 强于行业指数15%以上；

持有： 强于行业指数5%~15%；

中性： 相对于行业指数表现在-5%~5%之间；

卖出： 弱于行业指数5%以上；

未评级： 研究员基于覆盖或公司停牌等其他原因不能对该公司做出股票评级的情况。

要求披露

本报告由中山证券有限责任公司（简称“中山证券”或者“本公司”）研究所编制。中山证券有限责任公司是经监管部门批准具有证券投资咨询业务资格的机构。

风险提示及免责声明：

★市场有风险，投资须谨慎。本报告提及的证券、金融工具的价格、价值及收入均有可能下跌，以往的表现不应作为日后表现的暗示或担保。您有可能无法全额取回已投资的金额。

★本报告无意针对或者打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。

★本报告是机密的，仅供本公司的个人或者机构客户（简称客户）参考使用，不是或者不应当视为出售、购买或者认购证券或其他金融工具的要约或者要约邀请。本公司不因收件人收到本报告而视其为本公司的客户，如收件人并非本公司客户，请及时退回并删除。若本公司之外的机构发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，本公司及本公司雇员不为前述机构之客户因使用本报告或者报告载明的内容引起的直接或间接损失承担任何责任。

★任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等都只是研究观点的简要沟通，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

★ 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但是本公司不保证该资料及信息的准确性、完整性，我公司将随时补充、更新和修订有关资料和信息，但是不保证及时公开发布。本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告列明的发布日期当日的判断，本公司可以在不发出通知的情况下做出更改。本报告所包含的分析基于各种假设和标准，不同的假设和标准、采用不同的观点或分析方法可能导致分析结果出现重大的不同。本公司的销售人员、交易人员或者其他专业人员、其他业务部门也可能给出不同或者相反的意见。

★ 本报告可能附带其他网站的地址或者超级链接，对于可能涉及的地址或超级链接，除本公司官方网站外，本公司不对其内容负责，客户需自行承担浏览这些网站的费用及风险。

★ 本公司或关联机构可能会持有本报告所提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能已经、正在或者争取向这些公司提供投资银行业务等各类服务。在法律许可的情况下，本公司的董事或者雇员可能担任本报告所提及公司的董事。撰写本报告的分析师的薪酬不是基于本公司个别投行收入而定，但是分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投行、销售与交易业务。因此，客户应当充分注意，本公司可能存在对报告客观性产生影响的利益冲突。

★ 在任何情况下，本报告中的信息或者所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，任何人不应将本报告作为做出投资决策的惟一因素。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不就本报告的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。除法律强制性规定必须承担的责任外，本公司及雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

★ 本报告版权归本公司所有，保留一切权利。除非另有规定外，本报告的所有材料的版权均属本公司所有。未经本公司事前书面授权，任何组织或个人不得以任何方式发送、转载、复制、修改本报告及其所包含的材料、内容。所有于本报告中使用的商标、服务标识及标识均为本公司所有。